单刀双掷开关芯片

关键指标

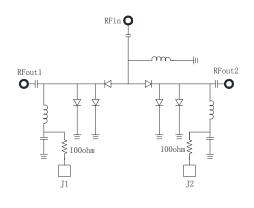
频率: 6~20GHz 插入损耗: 0.7dB 隔离度: 55dB P-1: 32dBm

电压/电流: -5V/24mA, +5V/22mA 芯片尺寸: 1.75mm×1.25mm

产品简介

HG127K2A 是一款 $6\sim20GHz$ 反射式单刀双掷开 关芯片,插入损耗为 0.7dB,隔离度为 55dB。

原理框图

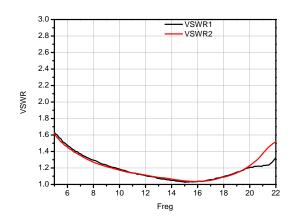


电性能(T_A=25℃, -5V/24mA, +5V/22mA)

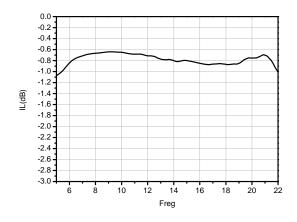
		•	
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)		6~20	
输入驻波	_	1.2	-
输出驻波	_	1.2	-
插入损耗(dB)	_	0.7	-
隔离度(dB)	_	55	-

典型测试曲线

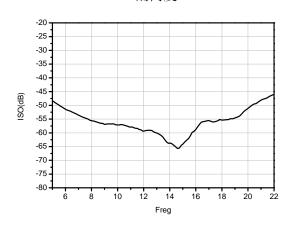
驻波



插入损耗



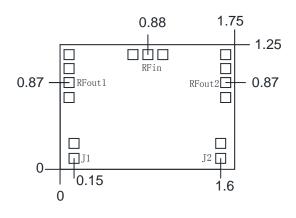
隔离度



真值表

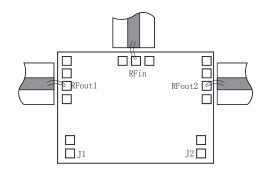
RFin-RFout1	RFin-RFout2	J1	J2
导通	关断	-5V/24mA	+5V/22mA
关断	导通	+5V/22mA	-5V/24mA

外形和端口尺寸 (mm)



单刀双掷开关芯片

推荐装配图



绝对额定最大值

最大输入功率	+33dBm
工作电压	-10V~10V
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65°C∼150°C

注意事项

- 1. 芯片在干燥、氮气环境中存储,在超净环境使用;
- 2. GaAs 材料较脆,不能触碰芯片表面,使用时必须小心;
- 3. 芯片用导电胶或合金烧结(合金温度不能超过 300℃,时间不能超过 30 秒),使之充分接地;
- 4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用 Φ25μm 双金丝键合,建议金丝长度 250~400μm;
- 5. 芯片微波端无隔直电容;
- 6. 芯片对静电敏感,在储存和使用过程中注意防静电。